证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材

**陕西斯瑞新材料股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-005

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会  新闻发布会 路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） |
| **形式** | 现场 网上 电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **序号** | **机构名称** | **姓名** | | 1 | 光大证券 | 周家诺、王礼沫 | |
| **时间** | 2025年2月19日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接**  **待人员姓名** | 证券事务代表：王磊 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | 1. **公司的高性能金属铬粉下游应用到哪些领域？**   答：公司的高性能金属铬粉产品系列包括高纯低气铬粉、真空级高纯铬、球形铬粉、片层状铬粉和超细铬粉等，下游广泛应用于中高压电接触材料、高端高温合金、高端靶材、表面喷涂、电子行业等领域，主要客户有GFE、西门子、西部超导等知名企业，公司是国内首家成功应用低温液氮技术，批量制造并向全球批量供应低氧、低氮、低硫、低酸不溶物高性能金属铬粉的企业。  **2、公司在人工智能领域方面的布局？**  答：公司是一家新材料研发制造企业，产品主要服务于轨道交通、航空航天、电力电子、医疗影像、新能源汽车、人工智能等领域。  400G以上光模块芯片对散热要求大幅提高，需要具有低膨胀更高导热特性的新材料来满足要求，不同成份的钨铜合金可以满足400G、800G、1.6T光模块需求。用于光模块芯片基座的钨铜材料主要技术要求是超细钨粉均匀弥散分布在铜相中，并且材料要求高洁净度、高致密度，不允许有任何气孔、夹杂、钨颗粒团聚，这些缺陷都会严重影响光模块组件焊接和使用性能。公司采用3D打印骨架、真空熔渗定向凝固、微精密加工、自建专用镀金线满足了这一细分市场的特殊需求。  同时，随着光芯片对散热要求的大幅提高，要求壳体材料具有更高的导热和力学性能，公司将新型铜合金应用于光模块壳体，解决行业技术痛点。  **3、公司有开发应用于核电、可控核聚变领域的新材料产品吗？**  答：公司已开发了应用于可控核聚变、大型核电发电机等关键材料和零组件。  **4、公司有哪些产品应用于半导体领域？**  答：公司产品在半导体领域的应用主要有以下几个方向：   1. 公司生产的光模块芯片基座是光模块核心部件光芯片的载体材料，可以应用于400G、800G、1.6T的光模块。 2. 公司开发了芯片半导体设备水冷组件，已通过下游龙头客户产品验证并实现批量供货。 3. 公司的高强高导铜合金制品可应用于半导体靶材配套零组件。 |
| **附件清单**  **（如有）** | 无 |
| **日期** | 2025年2月19日 |
| **备注** | 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。 |